

Title (en)

Composite structure with several stacked layers subjected to electromagnetic radiation

Title (de)

Schichtstruktur bestehend aus mehreren aufgefüllten Schichten, die einer elektromagnetischen Bestrahlung ausgesetzt wird

Title (fr)

Structure composite à plusieurs couches empilées soumise à un rayonnement électromagnétique

Publication

EP 1804336 A1 20070704 (FR)

Application

EP 06126432 A 20061218

Priority

FR 0600027 A 20060103

Abstract (en)

The structure has a stack of layers (20, 24-27) intercalated between layers (28-33) comprising a conductor pattern with polarization rotation function. The layers (20, 24-27) are made of a core material such as polyurethane or polymethacrylimide foam, and the layers (28-33) are made of a skin material such as epoxy glass or copper. The layers (20, 24-27) have recesses (21) crossing both sides of the layers (20, 24-27), where the recesses of two attached layers are connected two-by-two through holes (35) in the layers (28-33).

Abstract (fr)

La présente invention concerne une structure composite à plusieurs couches empilées soumise à un rayonnement électromagnétique. Elle comporte un empilement de plaques d'un matériau d'âme (20,24,25,26,27), les plaques de matériau d'âme étant intercalées entre des plaques d'un matériau de peau (28,29,30,31,32,33) comportant un motif conducteur, chaque plaque de matériau d'âme comportant des évidements (21) la traversant de part en part, les évidements de deux plaques mitoyennes de matériau d'âme étant reliés deux à deux par un trou (35) dans la plaque de matériau de peau les séparant. Application : détection et télécommunications

IPC 8 full level

H01Q 1/42 (2006.01); **H01Q 15/24** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01Q 1/02 (2013.01); **H01Q 1/424** (2013.01); **H01Q 1/425** (2013.01); **H01Q 15/242** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] US 4477815 A 19841016 - BRUNNER ANTON [DE], et al
- [Y] US 4829309 A 19890509 - TSUKAMOTO KATSUYA [JP], et al
- [A] GB 1416343 A 19751203 - SECR DEFENCE
- [A] FR 2344142 A1 19771007 - BALL CORP [US]
- [A] WO 02054538 A1 20020711 - CIT ALCATEL [FR], et al
- [A] US 2003174099 A1 20030918 - BAUER DONALD GEORGE [US], et al
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 12 5 December 2003 (2003-12-05) & DATABASE WPI Derwent World Patents Index; AN 2004-343512

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR MK YU

DOCDB simple family (publication)

EP 1804336 A1 20070704; FR 2895839 A1 20070706; FR 2895839 B1 20091218

DOCDB simple family (application)

EP 06126432 A 20061218; FR 0600027 A 20060103